

報道関係者各位

2010年4月16日

GIGABYTE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Intel H55 チップセット搭載、USB 3.0 対応モデル LGA1156、Intel Core i3/i5/i7、Pentium G 対応 DDR3 メモリ対応、HDMI 出力、ATX マザーボード GA-H55-USB3

GIGABYTE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel H55 チップセット搭載、USB3.0 対応 ATX マザーボード GA-H55-USB3 を 2010 年 4 月 17 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

GA-H55-USB3 は、グラフィックス統合型 CPU をサポートする H55 チップセットを搭載した ATX 規格、LGA1156、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i7(8xx シリーズ対応)、Intel Core i5、Intel Core i3、Intel Pentium G に対応します。グラフィックス統合型 CPU を使用することで、オンボードのグラフィックスを使用することができます。



USB 3.0 インターフェースに対応しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータの転送に威力を発揮します。3x USB Power Boost を搭載しています。USB に独自の電源回路を採用し、規格の 3 倍の電力出力を実現しています。USB 2.0/1.1 では 1,500mA、USB 3.0 では 2,700mA の電力供給ができ、バスパワー駆動デバイスの安定性を高めています。

GIGABYTE の独自の品質規格 Ultra Durable3 に対応しています。Ultra Durable2 に採用していた耐久性・低電圧・省電力パーツを基礎に、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用し、より高効率で低発熱、高い耐久性と信頼性を実現しました。

PCB 基板には、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用しています。電気抵抗が大幅に低減され、電力の損失および発熱を抑えることができます。高い負荷が発生するオーバークロック動作に最適なマザーボードです。

日本メーカー製の固体コンデンサを採用しています。低インピーダンス、低 ESR の固体コンデンサは従来の電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、高い耐久性を実現しています。

高効率なフェライトコアコイルを採用しています。フェライトコア(コイル)は、一般的な鉄製コアチョークに比べ錆びにくく、低 EMI(電磁波障害)で、低電力に優れたインダクタです。

独自の省エネ機能 Dynamic Energy Saver2 を搭載しています。専用のユーティリティソフトを使い、リアルタイムで省エネ状況の確認ができます。簡単な操作でシステム全体の電力をコントロールできます。Dynamic Energy Saver2 ではより高度な設定ができるので、優れた省電力を実現します。

DualBIOS を搭載しています。DualBIOS は、BIOS を 2 基搭載することで、アップデートの失敗など BIOS が使用不能になった場合に、自動的にセカンダリー BIOS に切り替え修復する機能です。

2本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3メモリをサポートし、動作周波数1666+MHzに対応します。

接続バスは、新世代バス規格のPCI Express2.0に対応しています。PCI Express1.1と互換性を持ち、データ転送速度が16レーンでは16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

SATA 3Gb/sインターフェイスに対応しています。SATA 1.5G/sインターフェイスの2倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audioに対応しています。最大8チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。光角型SPDIFとを備えています。

DisplayPortに対応しています。DisplayPortは、DVIの後継規格として設計された映像出力インターフェースの規格です。小型化や高速化が可能な次世代映像出力インターフェースとして期待されています。

HDMIに対応しています。HDMIは、コンピュータとディスプレイを接続する為のインターフェイス規格DVIをベースにAV向けに発展させた規格です。Full HD 1080Pと、著作権保護技術HDCPをサポートします。

6つの便利な機能が詰まったソフトSMART6を付属しています。QUICKBOOST、リカバリー、DualBIOS、モニタリング、電源ON/OFF等の各種設定が簡単に行えます。

対応CPUは、LGA1156、Intel Core i3/i5/i7、Pentium Gプロセッサです。対応メモリは、メモリスロット×4、DDR3、クロック1666+/1333/1066/800MHz、最大16GBまで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16スロット×1(x16動作)、PCI Express x1スロット×3、PCIスロット×3です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s×7[※1]、IDE×1、FDD×1、USB 2.0/1.1×12(リアパネルI/Oポート×6[※2]、内部I/Oコネクタ×6)[※3]、USB 3.0×2、IEEE1394×2(リアパネルI/Oポート×1、内部I/Oコネクタ×1)[※3]、eSATA×1です。リアパネルI/Oポートは、PS/2キーボードまたはマウス×1、D-sub×1、DVI-D×1、HDMI×1、DisplayPort×1、光角型SPDIF×1、USB 2.0/1.1×6[※2]、USB 3.0×2、IEEE1394a×1、eSATA×1、ギガビットLAN×1、オーディオ6ジャック×1。

同梱ケーブルは、SATAケーブル×2、IDEケーブル×1が付属[※2]します。フォームファクタはATX、サイズは305mm×244mmです。

[※1]GIGABYTEチップ制御の2つのSATAコネクタは、RAID0/1/JBODに対応しています。

[※2]USB 3.0ポートを含めます。

[※3]最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。

[※4]付属品は予告なく変更される可能性があります。。

【GA-H55-USB3 製品特徴】

・グラフィックス統合型 CPU をサポートする H55 チップセット搭載

GA-H55-USB3 は、グラフィックス統合型 CPU をサポートする H55 チップセットを搭載した ATX 規格、LGA1156、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i7(8xx シリーズ対応)、Intel Core i5、Intel Core i3、Intel Pentium G に対応します。グラフィックス統合型 CPU を使用することで、オンボードのグラフィックスを使用することができます。

・USB 3.0 インターフェイス対応、最大転送速度 5Gb/s を実現

USB 3.0 インターフェイスに対応しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータの転送に威力を発揮します。

・独自の品質規格 Ultra Durable3 搭載

GIGABYTE の独自の品質規格 Ultra Durable3 に対応しています。Ultra Durable2 に採用していた耐久性・低電圧・省電力パーツを基礎に、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用し、より高効率で低発熱、高い耐久性と信頼性を実現しました。

・省エネ機能 Dynamic Energy Saver2 搭載

独自の省エネ機能 Dynamic Energy Saver2 を搭載しています。専用のユーティリティソフトを使い、リアルタイムで省エネ状況の確認ができます。簡単な操作でシステム全体の電力をコントロールできます。Dynamic Energy Saver2 ではより高度な設定ができるので、優れた省電力を実現します。

・従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層

PCB 基板には、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用しています。電気抵抗が大幅に低減され、電力の損失および発熱を抑えることができます。高い負荷が発生するオーバークロック動作に最適なマザーボードです。

・長寿命 日本製固体コンデンサ採用

日本メーカー製の固体コンデンサを採用しています。低インピーダンス、低 ESR の固体コンデンサは従来の電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、高い耐久性を実現しています。

・高効率 フェライトコア(コイル)採用

高効率なフェライトコアコイルを採用しています。フェライトコア(コイル)は、一般的な鉄製コアチョークに比べ錆びにくく、低 EMI(電磁波障害)で、低電力に優れたインダクタです。高周波における急速なエネルギー損失を抑え、優れたエネルギー効率を実現しています。

・DualBIOS 搭載

DualBIOS を搭載しています。DualBIOS は、BIOS を 2 基搭載することで、アップデートの失敗など BIOS が使用不能になった場合に、自動的にセカンダリーBIOS に切り替え修復する機能です。

・3x USB Power Boost 搭載

3x USB Power Boost を搭載しています。USB に独自の電源回路を採用し、規格の 3 倍の電力出力を実現しています。USB 2.0/1.1 では 1,500mA、USB 3.0 では 2,700mA の電力供給ができ、バスパワー駆動デバイスの安定性を高めています。

・デュアルチャンネル DDR3 1666+対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 1666+MHz に対応します。

・PCI Express2.0 対応

接続バスは、新世代バス規格の PCI Express2.0 に対応しています。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

・SATA 3Gb/s インターフェイス対応

SATA 3Gb/s インターフェイスに対応しています。SATA 1.5G/s インターフェイスの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

・8 チャンネルオーディオ対応

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 8 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。光角型 SPDIF とを備えています。

・DisplayPort 対応

DisplayPort に対応しています。DisplayPort は、DVI の後継規格として設計された映像出力インターフェースの規格です。小型化や高速化が可能な次世代映像出力インターフェースとして期待されています

・HDMI 対応

HDMI に対応しています。HDMI は、コンピュータとディスプレイを接続する為のインターフェイス規格 DVI をベースに AV 向けに発展させた規格です。Full HD 1080P と、著作権保護技術 HDCP をサポートします。

・著作権保護機能 HDCP 対応

デジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護機能 HDCP に対応しています。伝送中のコンテンツ漏えいを防ぐため、高精細な次世代 DVD ディスクの映像は HDCP 対応機器とディスプレイがなければ見ることはできません。

・6 つの便利な機能が詰まったソフト SMART6 付属

6 つの便利な機能が詰まったソフト SMART6 を付属しています。QUICKBOOST、リカバリー、DualBIOS、モニタリング、電源 ON/OFF 等の各種設定が簡単に行えます。

・Windows 7 認証！

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 の環境で安心して使うことができます。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

・新しい環境配慮設計 ErP をサポート

ErP をサポートします。ErP (Energy-related Products) 指令とは環境配慮設計に関する、欧州連合の新しい指令です。詳しくは下記 URL をご覧下さい。

(http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/mb_091126_eup/tech_091126_eup.ht)

【GA-H55-USB3 製品詳細】

型番	GA-H55-USB3	
CPU	対応ソケット	LGA1156

	対応 CPU	Intel Core i7(8xx シリーズ対応) Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Pentium G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel H55 Express	
メモリ	メモリスロット	4
	メモリ規格	DDR3 1666+/1333/1066/800 MHz
	メモリ最大容量	16GB
	デュアルチャンネル対応	
オンボードグラフィックス	Intel H55 チップ	D-Sub DVI-D HDMI DisplayPort ※オンボードグラフィックスを使用するには、グラフィックス統合型 CPU(Core i5 6xxシリーズ、Core i3、Pentium G)を使用する必要があります。
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC889
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111D
拡張スロット	PCI Express x16	1(x16 動作)、PCI Express 2.0 対応
	PCI Express x1	3
	PCI	3
	ATI CrossFireX	---
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel H55 チップ	5
	GIGABYTE チップ	2(RAID0/1/JBOD 対応)
IDE	GIGABYTE チップ	1(ATA-133/100/66/33 2 台まで)
USB 2.0/1.1	Intel H55 チップ	最大 12(バックパネルコネクタ×6、内部 I/O コネクタ×6)※最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。
USB 3.0	NEC チップ	最大 2(リアパネル I/O ポート×2)
IEEE1394a	TSB43AB23 チップ	最大 2(リアパネル I/O ポート×1、内部 I/O コネクタ×1) ※最大数利用するには別途 IEEE ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX8 ピン 12V 補助電源	1
	FDD	1

	IDE	1
	SATA 3Gb/s	7
	CPU ファン	1
	システムファン	2
	フロントパネル接続	1
	フロントオーディオ接続	1
	CDIN	1
	S/PDIF 入力	1
	S/PDIF 出力	1
	USB 2.0/1.1	3
	IEEE 1394a	1
	シリアル	1
	クリア CMOS ジャンパ	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボードまたはマウス	1
	D-Sub	1
	DVI-D	1
	光角型 SPDIF	1
	DisplayPort	1
	USB 2.0/1.1	6 (USB 3.0 ポートを含む)
	USB 3.0	2
	IEEE 1394a	1
	eSATA	1
	オーディオジャック	6
I/O コントローラ	チップ	iTE IT8720
BIOS	特徴	16 Mbit フラッシュ × 2
		AWARD BIOS
		DualBIOS
	実装バージョン	PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	ATX
	サイズ	305mm × 244mm
付属品	SATA ケーブル	2
	IDE ケーブル	1

【GA-H55-USB3 発売詳細】

-発売日

2010年4月17日

-型番

GA-H55-USB3

-店頭予想売価

15,800円前後 (OPEN)

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=665>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/gigabyte-intel/gah55usb3.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

GIGABYTE 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

GIGABYTE 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>